IEC 60191-6-18 (Edition 1.0 - 2010)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6-18: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages – Design guide for ball grid array (BGA)

CEI 60191-6-18 (édition 1.0 - 2010)

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-18: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs pour montage en surface – Guide de conception pour les boîtiers matriciels à billes (BGA)

CORRIGENDUM 2

3.1 ball grid array BGA

This correction applies to the French only.

3.1 boîtier matriciel à billes BGA

Remplacer la note existante par la nouvelle note qui suit:

NOTE Dans la présente norme, BGA signifie « Boîtier matriciel à billes », nom conforme aux normes existantes (Voir Bibliographie).

July 2010 Juillet 2010